Karta danych technicznych produktu
Parametry

TSXP57104M
Premium CPU 512 DI/O 24AI/O, Unity



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyki Modicon Premium
Typ produktu lub komponentu	Procesor Unity
Oznaczenie oprogramowania	Unity Pro

Parametry uzupełniające

Liczba racków	2 12 slotów 4 4/6/8 sloty
Liczba slotów	16 24 32
Pojemnosc procesora WE/Wy dyskretnych	512 WE/WY
Pojemność analogowego procesora WE/WY	24 WE/WY
Liczba zastosowań na konkretny kanał	8
Połączenie typu zintegrowanego	Nieizolowane połączenie szeregowe 2 żeńskie mini DIN złącze (RS485) (19.2 kbit/s)
Procesor modułu komunikacyjnego	2 1
Opis pamięci	Wewnętrzna pamięć RAM (z kartą PCMCIA) 224 kB program Wewnętrzna pamięć RAM (z kartą PCMCIA) 96 kB dane Wewnętrzna pamięć RAM (bez karty PCMCIA) 96 kB program i dane Karta PCMCIA 256 kB dodatkowa przestrzeń do przechowywania danych
Maksymalny rozmiar powierzchni obiektu	32 kB (dane podstawowe i uzyskane) niezlokalizowane dane wewnętrzne 4096 %Mi lokalne bity wewnętrzne 64 %KWi słów stałych lokalne dane wewnętrzne 64 %MWi słów wewnętrznych lokalne dane wewnętrzne 64 kB (bloki funkcyjne DFB i EFB) niezlokalizowane dane wewnętrzne
Struktura aplikacji	32 zdarzeń 1 zadanie główne 1 szybkie zadanie
Czas wykonania na instrukcję	0.19 µs Boole'owski bez karty PCMCIA 0.25 µs Boole'owski z kartą PCMCIA 0.25 µs słowo lub arytmetyka stałoprzecinkowa bez karty PCMCIA 0.5 µs słowo lub arytmetyka stałoprzecinkowa z kartą PCMCIA 1.75...2.6 µs zmienne punkty z kartą PCMCIA 1.75...2.6 µs zmienne punkty bez karty PCMCIA
Liczba rozkazów na ms	2.1 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka z kartą PCMCIA 3.1 Kinst/ms 100 % Boole'owski z kartą PCMCIA 3.71 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka bez karty PCMCIA 4.76 Kinst/ms 100 % Boole'owski bez karty PCMCIA
Układ napowietrzny	0,3 Ms dla szybkie zadanie 1 ms dla zadanie nadrzędne
Oznakowanie	CE

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Sygnalizacja lokalna	Praca procesora (RUN): 1 LED (zielony) Błąd konfiguracji modułu WE/WY: 1 LED (czerwony) Procesor lub awaria systemu (ERR): 1 LED (czerwony) Aktywność w TER lub AUX (TER): 1 LED (żółty)
Obciążenie prądowe	850 mA w 5 V DC
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,38 kg

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa A 73/23/EEC 89/336/EEC UL 508 92/31/EEC 93/68/EEC CSA C22.2 nr 142 CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa C CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa D CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 grupa B IEC 61131-2
Certyfikaty produktu	RMRS GL LR ABS BV DNV RINA
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C
Wilgotność względna	10…95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji podczas pracy 5…95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji podczas przechowywania
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Pokrycie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	2

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	566 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	6,792 kg

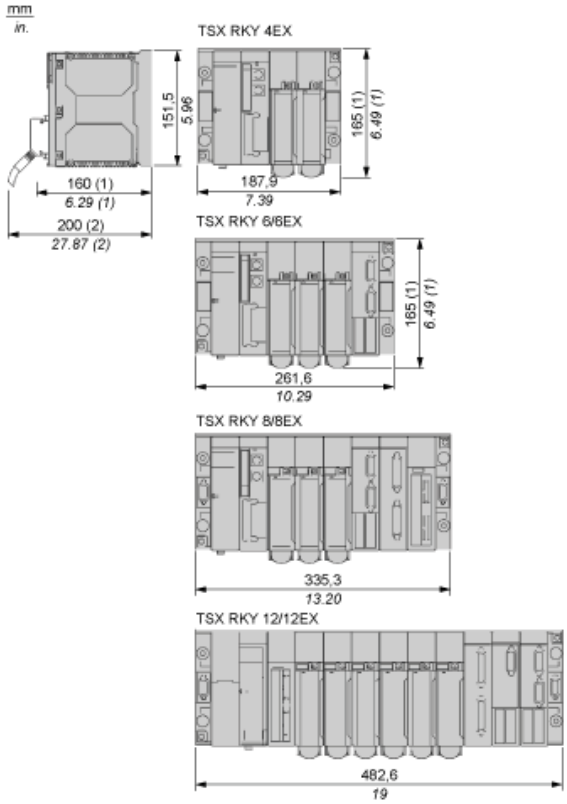
Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Dimensions Drawings

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



(1) With screw terminal block modules.

(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.